

证券代码：688233

证券简称：神工股份

公告编号：2023-007

锦州神工半导体股份有限公司

关于部分募投项目延期的公告

本公司董事会、全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

锦州神工半导体股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 2 月 20 日召开了第二届董事会第十次会议、第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意公司对部分募投项目达到预定可使用状态的时间进行调整。公司独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见，保荐机构国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”）对本事项出具了明确的核查意见。该事项无需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意锦州神工半导体股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可 2020[100]号）核准，公司采用战略配售、网上网下方式发行人民币普通股（A 股）4,000 万股，发行价格为每股 21.67 元。截至 2020 年 2 月 17 日，本公司实际已向社会公开发行人民币普通股（A 股）4,000 万股，募集资金总额 866,800,000.00 元，扣除承销费、保荐费 76,049,433.93 元后的 790,750,566.07 元已于 2020 年 2 月 17 日分别存入公司在中国工商银行股份有限公司锦州桥西支行 0708004329200067771 账户 300,000,000.00 元，存入锦州银行股份有限公司金凌支行 410100692121518 账户 300,000,000.00 元，存入在锦州农村商业银行股份有限公司营业部 392212010160740453 账户 190,750,566.07 元；减除审计费、律师费、信息披露等发行费用 15,881,132.08 元后，实际募集资金净额为人民币 774,869,433.99 元。上述资金到位情况已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了大信验字[2020]第 1-00010 文号的验资报告。

公司依照规定对募集资金采取了专户存储管理，并与保荐机构、募集资金专

户监管银行签订了募集资金三方监管协议。具体情况详见 2020 年 2 月 20 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《首次公开发行股票科创板上市公告书》。

二、募集资金投资项目情况

受资本市场融资环境等因素影响，公司本次发行募集资金净额为 774,869,433.99 元，小于《锦州神工半导体股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》中项目拟使用募集资金的总投资额 110,200.22 万元。截至 2022 年 6 月 30 日，公司募集资金的具体使用情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	项目投资总额	募集资金承诺投资总额	调整后募投总额	截至 2022 年 6 月 30 日募集资金累计投入	截至 2022 年 6 月 30 日投入进度（%）
1	8 英寸半导体级硅单晶抛光片生产建设项目	86,923.41	86,923.41	60,000.00	31,834.81	53.06
2	研发中心建设项目	23,276.81	23,276.81	17,486.94	17,505.88	100.11 (已结项)
合计		110,200.22	110,200.22	77,486.94	49,340.69	63.68

注 1：公司募投项目及募集资金使用情况具体详见公司于 2022 年 8 月 30 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《锦州神工半导体股份有限公司关于 2022 年半年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2022-036）。

注 2：2021 年 12 月 27 日，公司召开第二届董事会第三次会议、第二届监事会第三次会议，分别审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，公司将募投项目“8 英寸半导体级硅单晶抛光片生产建设项目”的预定可使用状态日期调整至 2023 年 2 月，具体内容详见公司于 2021 年 12 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《锦州神工半导体股份有限公司关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：2021-053）。

三、本次部分募投项目延期的具体情况

（一）本次募投项目延期情况

结合目前公司募集资金投资项目的实际建设情况和投资进度，在募集资金投

资用途及投资规模不发生变更的情况下，对项目达到预定可使用状态的时间进行调整，具体如下：

序号	项目名称	原计划达到预定可使用状态日期	延期后达到预定可使用状态日期
1	8 英寸半导体级硅单晶抛光片生产建设项目	2023 年 2 月	2024 年 2 月

（二）本次募投项目延期的原因

由于国内新冠疫情反复爆发，上述项目涉及的设备采购、装机调试、物流运输等多重事项均受到一定程度滞后影响，导致公司募投项目进度不及原计划预期。为提高募集资金利用率，根据公司目前实际情况及市场需求，公司拟有计划、分步逐步投入该项目，故将该项目的达到预定可使用状态时间调整至 2024 年 2 月。

四、本次部分募投项目延期的影响

本次募投项目延期是公司根据项目实施的实际情况做出的审慎决定，未改变募投项目的投资内容、投资总额、实施主体，不会对募投项目的实施造成实质性的影响。本次调整不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，符合公司长期发展规划。

五、专项意见说明

（一）独立董事意见

经审议，独立董事认为：本次募投项目延期是公司根据项目实施的实际情况做出的审慎决定，有利于保证募投项目的建设成果更好地满足公司发展规划要求，不会对公司的正常经营产生重大不利影响。决策和审批程序符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定，不存在变相改变募集资金投向和损害股东特别是中小股东利益的情形。综上，我们一致同意本次《关于部分募投项目延期的议案》。

（二）监事会意见

经审议，监事会认为：本次募投项目延期是公司根据项目实施的实际情况做出的审慎决定，不属于募投项目的实质性变更以及变更改变募集资金用途的情形，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。决策和审批程序符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定，因此，我们一致同意本次《关于部分募投项目延期的议案》。

（三）保荐机构意见

经核查，保荐机构国泰君安证券股份有限公司认为：本次募集资金投资项目延期事宜已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了同意的独立意见，履行了必要的决策程序，符合相关法律、法规、规范性文件的要求。综上，保荐机构对公司本次募集资金投资项目延期事项无异议。

六、上网公告附件

（一）《锦州神工半导体股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十次会议相关事项的独立意见》；

（二）《国泰君安证券股份有限公司关于锦州神工半导体股份有限公司部分募投项目延期的核查意见》。

特此公告。

锦州神工半导体股份有限公司董事会

2023年2月21日